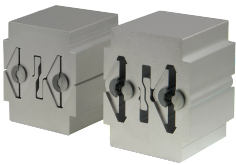


Interscale 柔性散热器 (FHC), 70 mm

物料号

24830-001

导体块会垂直膨胀/收缩以补偿累积的容差，还会优化热路径的表面接触和压力；无需使用导热垫片。



认证



功能

专为使用带有以下插座的 Intel Core-i 处理器和 AMD 处理器的 ATX/ITX/Mini ITX 和 COM 产品而设计：Intel：LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011；AMD：AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

兼容 Interscale C 型机箱

提供行业领先的传导冷却性能，比当前的传导冷却方法提高 70%

导体块会垂直膨胀/收缩以补偿累积的容差，还会优化热路径的表面接触和压力；无需使用导热垫片

用安装支架固定在 PCB 上，单独出售

产品属性

产品类型: 导体块

产品系列: Interscale

类型: 热导体

搭配: 仪器箱

包装数量: 1

深度: 50mm

宽度: 50mm

完成: 阳极氧化; 镀锌铝

Gross Weight: 0.609kg

材料: 铝; 钢

其他产品详情

请订购用于将 FHC 装配到电路板上的安装支架（Intel 或 AMD，在“附件”部分中列出）。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE